

株主・投資家の皆様へ 第76期 報告書

平成23年4月1日 ▶ 平成24年3月31日

目次

ごあいさつ	1
製品別の売上概況	3
販売の状況	6
連結貸借対照表	7
連結損益計算書	8
連結キャッシュ・フロー計算書/個別業績の概要	9
トピックス	10
株式の状況/大株主の状況	12
株主還元/会社概要	13
役員および執行役員	14

Innovator in Electronics

muRata

株式会社 村田製作所

証券コード：6981

ごあいさつ

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
第76期(平成24年3月期)の報告書をお届けするにあたり、当社グループの業績概要についてご報告申し上げます。

当期の業績について

当連結会計年度の世界の経済情勢は、東日本大震災によるサプライチェーンの混乱が想定より早く治まったものの、欧州金融不安や新興国の経済成長率鈍化、タイの洪水によるサプライチェーンの混乱、円高の長期化などにより、先行きが不透明な状況で推移しました。当社が属するエレクトロニクス市場におきましては、スマートフォンやタブレット端末、震災後の落ち込みから回復した自動車の生産は、堅調に推移しましたが、ノートパソコンや薄型テレビの生産は、前連結会計年度を下回りました。

このような市場環境のもと、当社は、生産性改善や固定費抑制などのコストダウンに継続して取り組むとともに、平成22年度を初年度とする中期3カ年計画を完遂すべく、

- ・中核市場、新規市場での事業機会拡大を狙い、ルネサスエレクトロニクス株式会社のパワーアンプ事業とVTI Technologies Oyの買収、東光株式会社との資本・業務提携、
- ・新興国市場での販売力強化のため、中国の内陸部、インドへの販売拠点の展開、
- ・海外生産の拡大に向け、中国・無錫、タイ・チェンマイ、中国・深圳といった既存工場での生産棟の増設と増産体制の確立に加え、フィリピン生産子会社の設立、などの取り組みを進めてまいりました。

これらの結果、当社の当連結会計年度の業績は、以下のとおりとなりました。

売上高は、カーエレクトロニクス向けが、自動車の生産台数の増加に加え、電装化の進展により好調だったほか、スマートフォン、タブレット端末向けが増加しましたが、その他の用途が、ノートパソコンや薄型テレビ等の生産台数の減少や製品価格の値下がり、円高進行(前連結会計年度に比べ対米ドルの平均レートで6円65銭の円高)により振るわず、全体では、前連結会計年度に比べ5.4%減の584,662百万円となりました。このうち、主たる事業である電子部品並びにその関連製品の製品売上高は582,209百万円となりました。

利益につきましては、売上高の減少、製品価格の値下がりや円高といった減益要因を、コストダウンで補うことができず、営業利益は前連結会計年度比42.0%減の44,973百万円、税引前当期純利益は同37.9%減の50,931百万円、当期純利益は同42.4%減の30,807百万円となりました。

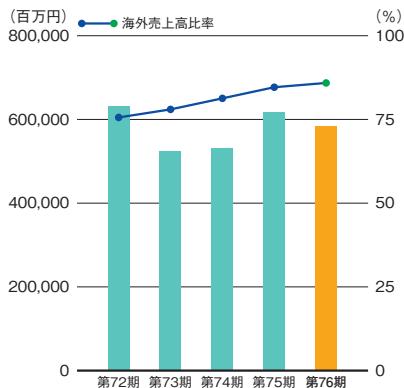
次期の見通し

次期の世界の経済情勢は、欧州の景気低迷や中国での経済成長率の鈍化といった懸念材料があるものの、当社が属するエレクトロニクス市場におきましては、主要な電子機器の生産回復が見込まれること、スマートフォンやタブレット端末、カーエレクトロニクス向けで引き続き高い成長が見込まれることから、需要の堅調な伸びが期待できます。

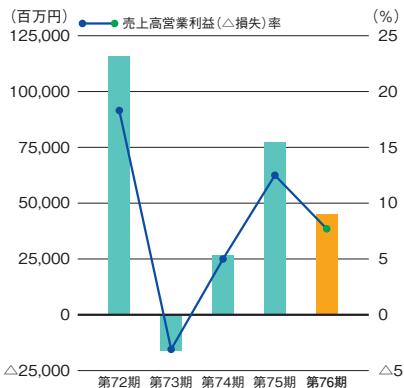
このような状況のもと、次期の業績予想を以下のとおりといたしました。

次期の売上高は、スマートフォンやタブレット端末の台数

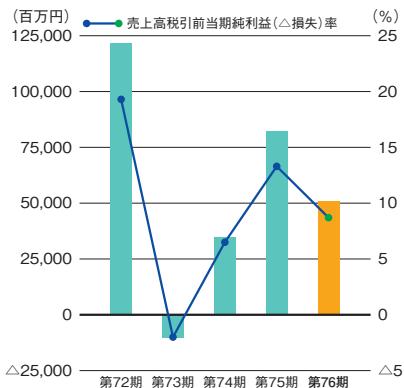
■売上高 / 海外売上高比率



■営業利益(△損失) / 売上高営業利益(△損失)率



■税引前当期純利益(△損失) / 売上高税引前当期純利益(△損失)率



成長から、通信モジュールやその他コンポーネントで高い伸びを見込むことに加え、主要な電子機器の需要回復でコンデンサをはじめとした部品全般の増加を織り込み、当連結会計年度に比べ16.3%増の680,000百万円を計画しております。利益につきましては、製品価格の値下がり、研究開発費を中心とした先行投資の増加といった減益要因が見込まれますが、新製品の継続的な投入とコストダウンの取り組みを進め、営業利益は68,000百万円(当連結会計年度比51.2%増)、税引前当期純利益は72,000百万円(同41.4%増)、当期純利益は48,000百万円(同55.8%増)と大幅な増益を計画しております。

設備投資は、新製品や需要の拡大が期待できる製品の生産能力増強投資、製品コスト削減のための合理化投資、研究開発投資を中心に、全体で68,000百万円を計画しております。

株主還元策について

株主の皆様への利益還元策としましては、配当による成果の配分を優先的に考え、長期的な企業価値の拡大と企業体質の強化を図りながら、1株当たり利益を増加させることにより配当の安定的な増加に努めることを基本方針としております。この方針に基づき、連結ベースでの業績と配当性向並びに内部留保の蓄積などを総合的に勘案したうえで、配当による利益還元を行っております。

また、当社は自己株式の取得につきましても株主の皆様への利益還元策としてとらえており、資本効率の改善を目的に適宜実施しております。

当期(平成24年3月期)の1株当たり期末配当金は50円としており、既に実施済みの中間配当金とあわせた年間配当金は、

前期と同額の100円となります。なお、当期は15,000百万円、3,555,300株の自己株式を取得しました。

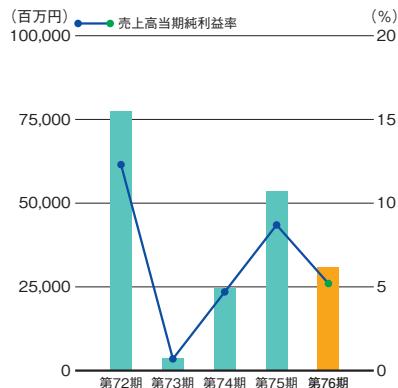
次期(平成25年3月期)の1株当たり配当金は、連結業績予想と配当性向並びに将来の発展のための再投資に必要な内部留保の蓄積などを総合的に勘案して、当期と同額の年間100円(中間配当金50円、期末配当金50円)とすることを予定しております。なお、この1株当たり配当金は、現時点の事業環境及び次期の業績見通しによるものです。

(注)業績予想の前提条件及び注意事項については当社決算短信6、7ページをご参照ください。決算短信は当社ホームページでもご覧いただけます。

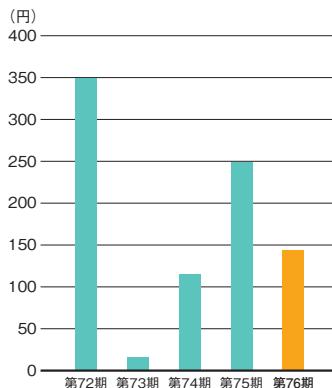


代表取締役社長 村田恒夫

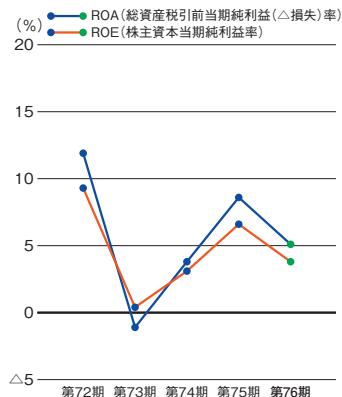
■当期純利益 / 売上高当期純利益率



■1株当たり当期純利益



■ROA / ROE



製品別の売上概況

当連結会計年度の製品別の売上高を前連結会計年度と比較した概況は、以下のとおりであります。

コンポーネント

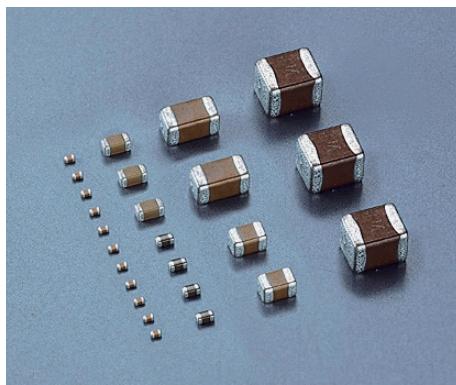
当連結会計年度のコンポーネントの売上高は、前連結会計年度に比べ6.0%減の399,232百万円となりました。

コンデンサ

この区分には、積層セラミックコンデンサなどが含まれます。

当連結会計年度は、主力のチップ積層セラミックコンデンサが、携帯電話、カーエレクトロニクス向けは、数量の増加と小型・大容量化の進展による品種構成の良化により好調でしたが、AV機器、コンピュータ及び関連機器向けが振るわず、全体では減少となりました。

その結果、コンデンサの売上高は、前連結会計年度に比べ5.9%減の208,386百万円となりました。



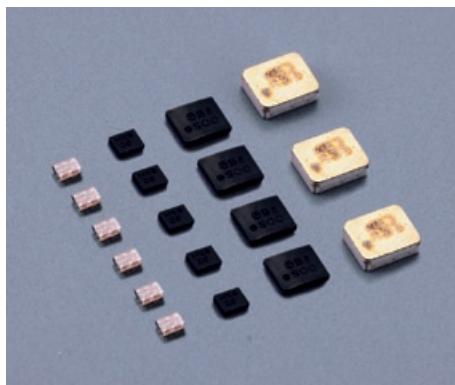
チップ積層
セラミック
コンデンサ

圧電製品

この区分には、表面波フィルタ、セラミック発振子、圧電センサ、セラミックフィルタなどが含まれます。

当連結会計年度は、表面波フィルタが、携帯電話の生産台数の増加とマルチバンド化に伴う携帯電話1台当たりの搭載点数の増加により、数量では増加となりましたが、値下がりや円高の影響から、金額では微減となりました。セラミック発振子は、家電やAV機器向けが振るいませんでした。圧電センサは、衝撃検知用センサが、タイの洪水による得意先のハードディスクドライブ生産の減少の影響で大幅に減少しました。

その結果、圧電製品の売上高は、前連結会計年度に比べ9.1%減の78,608百万円となりました。



表面波フィルタ

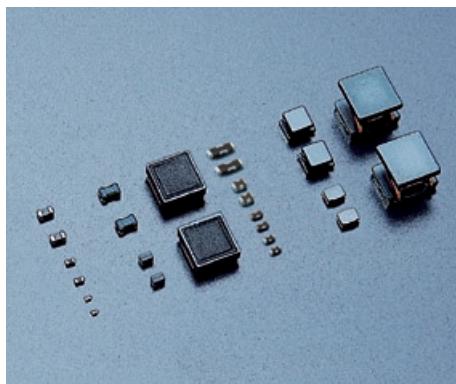
コンポーネント

その他コンポーネント

この区分には、EMI除去フィルタ、コイル、サーミスタ、コネクタ、センサなどが含まれます。

当連結会計年度は、EMI除去フィルタが、コンピュータ及び関連機器、カーエレクトロニクス向けは好調でしたが、AV機器、通信機器向けで落ち込み、前連結会計年度を下回りました。コイルは、携帯電話、タブレット端末、カーエレクトロニクス向けで堅調でした。コネクタは、携帯電話、タブレット端末向けで大幅に伸ばしました。

その結果、その他コンポーネントの売上高は、前連結会計年度に比べ4.1%減の112,238百万円となりました。



チップフェライトビーズ／チップコモンモードチョークコイル／エミフィル®／チップコイル

モジュール

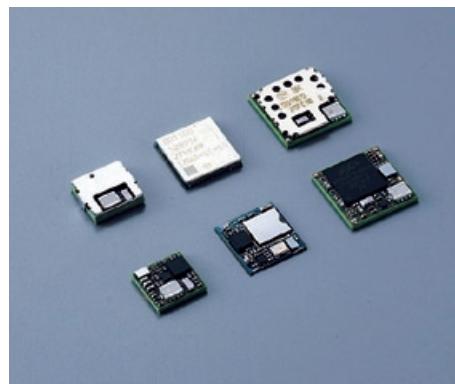
当連結会計年度のモジュールの売上高は、前連結会計年度に比べ4.1%減の182,977百万円となりました。

通信モジュール

この区分には、近距離無線通信モジュール、多層デバイス、回路モジュールなどが含まれます。

当連結会計年度は、近距離無線通信モジュールが、携帯メディアプレイヤー向けは減少となりましたが、スマートフォン向け等が増加し、全体では堅調でした。多層デバイスは、通信機器、コンピュータ及び関連機器向けで低調でした。

その結果、通信モジュールの売上高は、前連結会計年度に比べ3.2%減の133,915百万円となりました。



無線LAN向けモジュール (Wi-Fiモジュール)

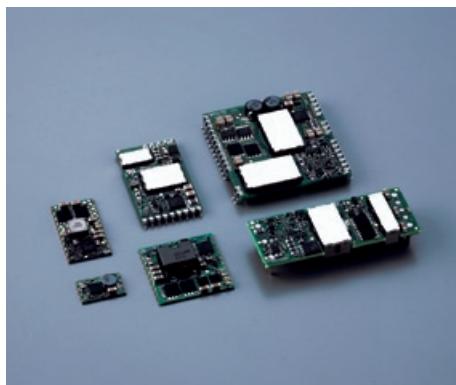
モジュール

電源他モジュール

この区分には、電源などが含まれます。

当連結会計年度は、電源が、カーエレクトロニクス向けは好調でしたが、その他の用途で振るわず、全体では減少となりました。

その結果、電源他モジュールの売上高は、前連結会計年度に比べ6.5%減の49,062百万円となりました。



DC-DCコンバータ

用語解説

■コンデンサ(3ページ)

コンデンサは電気を蓄える働きをし、電源の電圧変動を吸収して電子機器の安定動作に貢献する役割を担う部品です。携帯電話、パソコン、デジタル家電など、多くの電子機器に使われています。

■フィルタ(表面波/セラミック/EMI除去) (3,4ページ)

コーヒーのフィルタでイメージできるように、必要な信号だけを通し、不要な信号は通さない働きをします。表面波フィルタ、セラミックフィルタは特定の信号だけを通す役割をし、EMI除去フィルタは信号に含まれるノイズ(EMI = Electromagnetic Interference)を除去して電子回路を守ります。

■セラミック発振子(3ページ)

電子機器にはプロセッサやマイコンなどのデジタルICが多数使われていますが、デジタル信号処理を正しく動作させるためには、そのテンポを制御する「基準クロック信号」というものがが必要です。セラミック発振子は、圧電セラミックスの圧電現象(電圧を加えると伸縮し、物理的な力を加えると電圧を発生する)を利用し、基準クロック信号を発生させる電子部品です。

■サーミスタ(4ページ)

サーミスタとは、温度により抵抗値が変化するセラミックの抵抗体です。電子機器の小型化・高出力化が年々進む中、機器の機能だけでなく、機器の安全性・安定性対策にサーミスタ機能のニーズが高まっており、過熱検知・過電流保護・温度補償などの用途に展開されています。

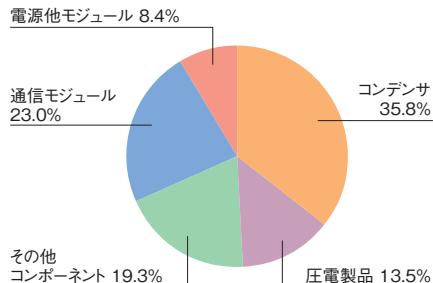
■多層デバイス(4ページ)

従来は1枚の基板上に多数の部品を実装して構成していた回路を、セラミックシートを何層も重ねて形成した多層セラミックスの内部に3次元で回路を構成し、部品の機能を作り込むことによって、小型化を実現した電子部品です。

販売の状況

(単位:百万円)

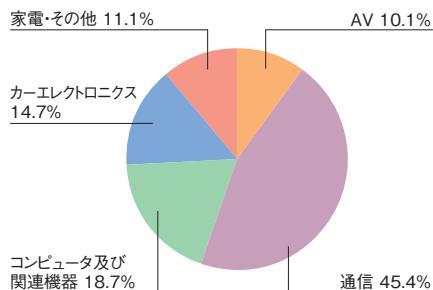
製品別売上高



期別 項目	前連結会計年度 (平成22年4月1日 ～平成23年3月31日)		当連結会計年度 (平成23年4月1日 ～平成24年3月31日)		増減	
		構成比 (%)		構成比 (%)		増減率 (%)
コンデンサ	221,427	36.0	208,386	35.8	△13,041	△5.9
圧電製品	86,442	14.0	78,608	13.5	△7,834	△9.1
その他コンポーネント	116,981	19.0	112,238	19.3	△4,743	△4.1
コンポーネント計	424,850	69.0	399,232	68.6	△25,618	△6.0
通信モジュール	138,283	22.5	133,915	23.0	△4,368	△3.2
電源他モジュール	52,489	8.5	49,062	8.4	△3,427	△6.5
モジュール計	190,772	31.0	182,977	31.4	△7,795	△4.1
製品売上高計	615,622	100.0	582,209	100.0	△33,413	△5.4

(単位:百万円)

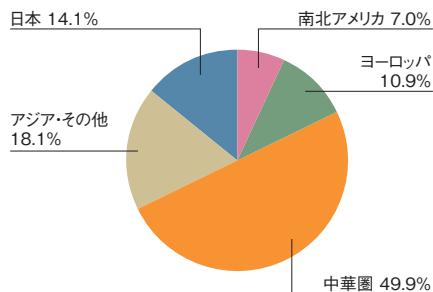
用途別売上高 (当社推計値に基づいております)



期別 項目	前連結会計年度 (平成22年4月1日 ～平成23年3月31日)		当連結会計年度 (平成23年4月1日 ～平成24年3月31日)		増減	
		構成比 (%)		構成比 (%)		増減率 (%)
AV	79,349	12.9	59,041	10.1	△20,308	△25.6
通信	269,994	43.9	264,175	45.4	△5,819	△2.2
コンピュータ及び関連機器	114,115	18.5	108,827	18.7	△5,288	△4.6
カーエレクトロニクス	79,710	12.9	85,365	14.7	5,655	7.1
家電・その他	72,454	11.8	64,801	11.1	△7,653	△10.6
製品売上高計	615,622	100.0	582,209	100.0	△33,413	△5.4

(単位:百万円)

地域別売上高



期別 項目	前連結会計年度 (平成22年4月1日 ～平成23年3月31日)		当連結会計年度 (平成23年4月1日 ～平成24年3月31日)		増減	
		構成比 (%)		構成比 (%)		増減率 (%)
南北アメリカ	46,796	7.6	40,552	7.0	△6,244	△13.3
ヨーロッパ	70,026	11.4	63,297	10.9	△6,729	△9.6
中華圏	297,095	48.3	290,657	49.9	△6,438	△2.2
アジア・その他	106,845	17.3	105,702	18.1	△1,143	△1.1
海外計	520,762	84.6	500,208	85.9	△20,554	△3.9
日本	94,860	15.4	82,001	14.1	△12,859	△13.6
製品売上高計	615,622	100.0	582,209	100.0	△33,413	△5.4

連結貸借対照表

(単位:百万円)

科目	期別 前連結会計年度末 (平成23年3月31日)		期別 当連結会計年度末 (平成24年3月31日)	
	金額	構成比	金額	構成比
		%		%
(資産の部)	(988,508)	(100.0)	(1,000,885)	(100.0)
流動資産	412,233	41.7	431,850	43.1
現金及び預金	48,880		54,460	
短期投資	35,445		25,391	
①有価証券	66,121		64,215	
受取手形	1,447		915	
売掛金	122,852		122,175	
貸倒引当金	△996		△761	
たな卸資産	110,450		132,037	
繰延税金資産	19,743		16,927	
前払費用及びその他の流動資産	8,291		16,491	
有形固定資産	283,988	28.7	304,934	30.5
土地	44,125		46,512	
建物及び構築物	274,188		284,023	
機械装置及び工具器具備品	586,831		627,961	
建設仮勘定	22,607		26,131	
減価償却累計額	△643,763		△679,693	
投資及びその他の資産	292,287	29.6	264,101	26.4
関連会社に対する投資	—		2,070	
①投資	244,609		195,773	
繰延税金資産	9,680		10,002	
その他の固定資産	37,998		56,256	
合計	988,508	100.0	1,000,885	100.0

(単位:百万円)

科目	期別 前連結会計年度末 (平成23年3月31日)		期別 当連結会計年度末 (平成24年3月31日)	
	金額	構成比	金額	構成比
		%		%
(負債の部)	(167,364)	(16.9)	(192,343)	(19.2)
流動負債	110,589	11.2	121,445	12.1
②短期借入金	7,841		30,392	
買掛金	33,598		36,940	
未払給与及び賞与	22,663		21,998	
③未払税金	24,623		2,712	
未払費用及びその他の流動負債	21,864		29,403	
固定負債	56,775	5.7	70,898	7.1
②長期債務	1,047		6,804	
退職給付引当金	53,755		62,303	
繰延税金負債	767		535	
その他の固定負債	1,206		1,256	
(資本の部)	(821,144)	(83.1)	(808,542)	(80.8)
資本金	69,377		69,377	
資本剰余金	102,396		102,396	
利益剰余金	733,862		743,206	
その他の包括損失累計額	△36,432		△43,373	
有価証券未実現損益	2,535		1,044	
年金負債調整勘定	△422		△4,687	
デリバティブ未実現損益	△34		△527	
為替換算調整勘定	△38,511		△39,203	
自己株式(取得原価)	△48,059		△63,064	
合計	988,508	100.0	1,000,885	100.0

Point

前連結会計年度末からの主な増減要因

①「有価証券」(△1,906百万円)及び「投資」(△48,836百万円)の減少

主に債券の償還があったことによるものです。

②「短期借入金」(22,551百万円)及び「長期債務」(5,757百万円)の増加

主にM&Aなどによる一時的な資金需要及び設備投資への対応によるものです。

③「未払税金」(△21,911百万円)の減少

主に課税所得の減少により未払法人税等が減少したことによるものです。

連結損益計算書

(単位:百万円)

科目	期別		前連結会計年度		当連結会計年度	
			(平成22年4月1日～平成23年3月31日)		(平成23年4月1日～平成24年3月31日)	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
売上高	617,954	100.0	584,662	100.0		
売上原価	415,059	67.2	413,784	70.8		
販売費及び一般管理費	85,632	13.9	84,927	14.5		
研究開発費	39,778	6.4	40,978	7.0		
営業利益	77,485	12.5	44,973	7.7		
受取利息及び配当金	4,502	0.7	4,769	0.8		
支払利息	△48	△0.0	△105	△0.0		
為替差損益	△827	△0.1	110	0.0		
その他(純額)	950	0.2	1,184	0.2		
税引前当期純利益	82,062	13.3	50,931	8.7		
法人税等	28,570	4.6	20,395	3.5		
(法人税、住民税及び事業税)	(29,503)		(12,510)			
(法人税等調整額)	(△933)		(7,885)			
持分法投資利益	—	—	271	0.1		
当期純利益	53,492	8.7	30,807	5.3		

(注) 当連結会計年度の持分法投資利益は、平成23年5月における東京電波株式会社の株式の追加取得(取得後の保有割合31.9%)に伴い持分法を適用したことによるものです。

Point

売上高は、カーエレクトロニクス向けが、自動車の生産台数の増加に加え、電装化の進展により好調だったほか、スマートフォン、タブレット端末向けが増加しましたが、その他の用途が、ノートパソコンや薄型テレビ等の生産台数の減少や製品価格の値下がり、円高進行により振るわず、全体では、前連結会計年度に比べ5.4%減の584,662百万円となりました。営業利益につきましては、売上高の減少、製品価格の値下がりや円高といった減益要因を、コストダウンで補うことができず、前連結会計年度比42.0%減の44,973百万円となりました。税引前当期純利益は同37.9%減の50,931百万円、当期純利益は同42.4%減の30,807百万円となりました。

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科 目	期 別	前連結会計年度	当連結会計年度
		(平成22年4月1日～平成23年3月31日)	(平成23年4月1日～平成24年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		105,610	57,589
投資活動によるキャッシュ・フロー		△133,999	△46,487
財務活動によるキャッシュ・フロー		△14,561	△9,148
換算レート変動による影響		△2,807	328
現金及び現金同等物の増加(△減少)額		△45,757	2,282
現金及び現金同等物の期首残高		108,777	63,020
現金及び現金同等物の期末残高		63,020	65,302

個別業績の概要

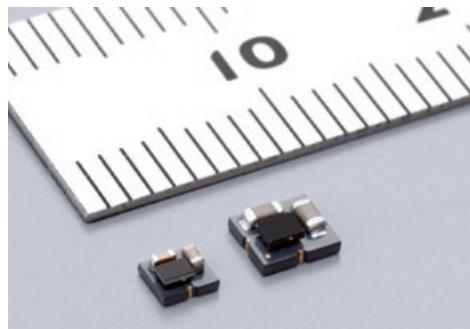
(単位:百万円)

科 目	期 別	前事業年度	当事業年度
		(平成22年4月1日～平成23年3月31日)	(平成23年4月1日～平成24年3月31日)
売上高		539,317	495,744
営業利益		18,643	3,212
経常利益		30,319	17,921
当期純利益		24,816	17,155
総資産		631,519	608,636
純資産		405,635	384,434
1株当たり当期純利益(円)		115.62	80.39

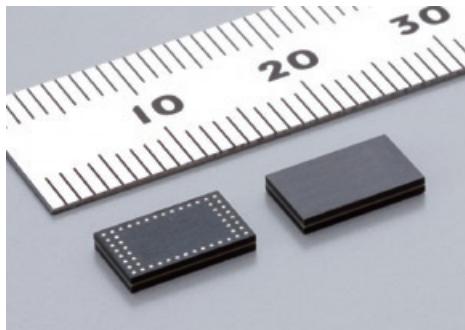
世界最小! マイクロDC-DCコンバータの開発および拡売の開始

電子機器の高機能化に伴い、各機能回路で個別に電源を供給することが必要となっています。当社では、部品実装面積削減、EMIノイズ対策、省エネ志向などの市場ニーズに対応するため、平成22年10月に開発・商品化した「マイクロDC-DCコンバータ」のさらなる小型化を進め、世界最小サイズを開発しました。ほかにも大電流対応品などラインアップを4シリーズに拡大し、拡売を開始しています。

これまで当社で培ってきた材料技術・多層プロセス技術・回路設計技術を組み合わせることで、インダクタ、EMIフィルタ機能を内蔵したフェライト基板を実現しました。また、電源ICとインダクタを一体化することで配線の最短化を実現し、EMI除去機能を内蔵することで高周波ノイズを低減しました。この部品は、スマートフォンなどモバイル機器全般に使用されます。今後も超小型、低EMIノイズの製品開発に取り組み、電源周辺回路設計の最適化に貢献してまいります。



部品内蔵技術を応用した通信モジュールの増産開始



急拡大しているスマートフォンの市場からの高集積・小面積化のニーズに応えるため、当社では部品内蔵技術と多層プロセス技術（薄層LTCC*基板）を組み合わせることで、超小型で高密度集積が可能な技術を確立しました。薄層LTCC基板は厚み200 μ mで10層を形成でき、モジュール内での配線効率に有利でモジュールの低背化が可能であるほか、基板内蔵用積層セラミックコンデンサ内蔵、実装面積の2分の1～4分の1削減などの特徴があります。昨年10月より同技術を応用したスマートフォン向け電源モジュールの量産を開始し、本年3月より近距離無線モジュール（Wi-Fiモジュール）として増産を開始しました。

今後もRFモジュールなど、さらなる部品内蔵モジュールの需要増大に対応してまいります。

※LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramics) :

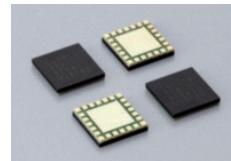
低温同時焼成セラミックス。通常の電子セラミックスは1,500 $^{\circ}$ C以上の高温で焼成されるが、LTCCは焼成温度が1,000 $^{\circ}$ C以下と低く、内層配線に導体抵抗の低い銀や銅を使うことが可能。

M&Aによる事業拡大

本年3月1日、ルネサス エレクトロニクス株式会社（以下「ルネサス」）のパワーアンプ事業部門及びルネサス東日本セミコンダクタ長野デバイス本部（ルネサスの100%子会社、以下「東セミ長野」）の買収を完了し、パワーアンプ事業部門はモジュール事業本部通信システム商品事業部PA商品部として、東セミ長野は株式会社小諸村田製作所として継承しました。また、



Murata Electronics Oy



PA*1モジュール

フィンランドのMEMS*2センサのメーカーであるVTI Technologies Oyについては、本年1月31日に買収を完了し、本年5月25日をもってMurata Electronics Oyに社名を変更いたしました。

これらのM&Aにより、既存製品との相乗効果を発揮させ、事業の更なる拡大に努めてまいります。

※1 PA(Power Amplifier):携帯機器から基地局へ信号を送信する際に、信号を増幅するはたらきをする部品。

※2 MEMS(Micro Electro Mechanical Systems):微小電子機械システムとも呼ばれる半導体集積回路の微細な加工技術。

出雲村田製作所の椿・桜の一般公開

当社グループの積層セラミックコンデンサの主力生産工場である株式会社出雲村田製作所（鳥根県出雲市斐川町）では、社会・地域貢献活動の一環として、事業所敷地内の椿・桜の一般公開を毎年春の開花時期に行っており、今年で19回目の開催となりました。



出雲村田製作所の敷地内には約1,000種類・1,130本の椿と、65種類・396本の桜を植栽しています。今年は3月25日、4月8日、4月15日の3日間で6,000人以上の方々が訪れ、花に彩られた構内で楽しんでいただくことができました。当日は200名余りの従業員ボランティアの参画のもと、ムラタセイサク君®やムラタセイコちゃん®が登場する科学教室も開催し、子ども達が楽しく学ぶ機会を提供することができました。

「そこにムラタのあることが、その地域の喜びであり、誇りでありたい」という理念のもと、これからも地域社会の一員として、社会・地域との交流活動を展開してまいります。

株式の状況

平成24年3月31日現在

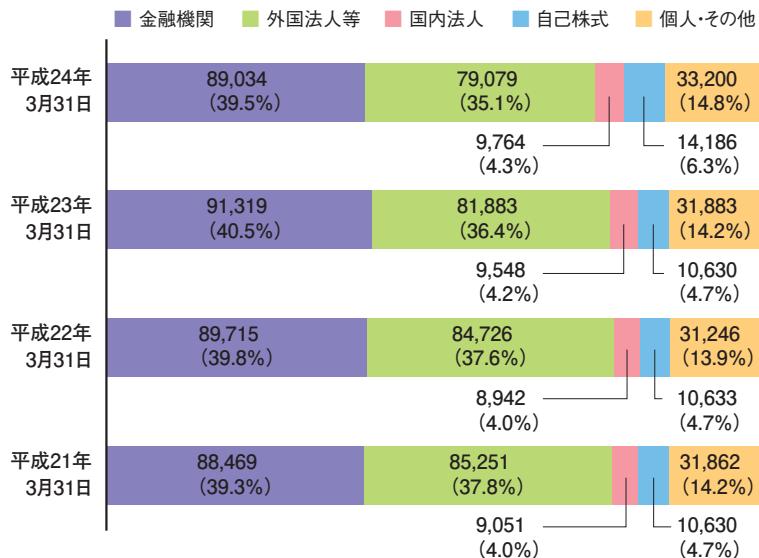
株式事項

発行済株式総数 225,263千株
株主数 80,035名

株式上場

[国内]
東京証券取引所 市場第一部
大阪証券取引所 市場第一部
[海外]
シンガポール証券取引所

所有者別分布状況(千株)



大株主の状況

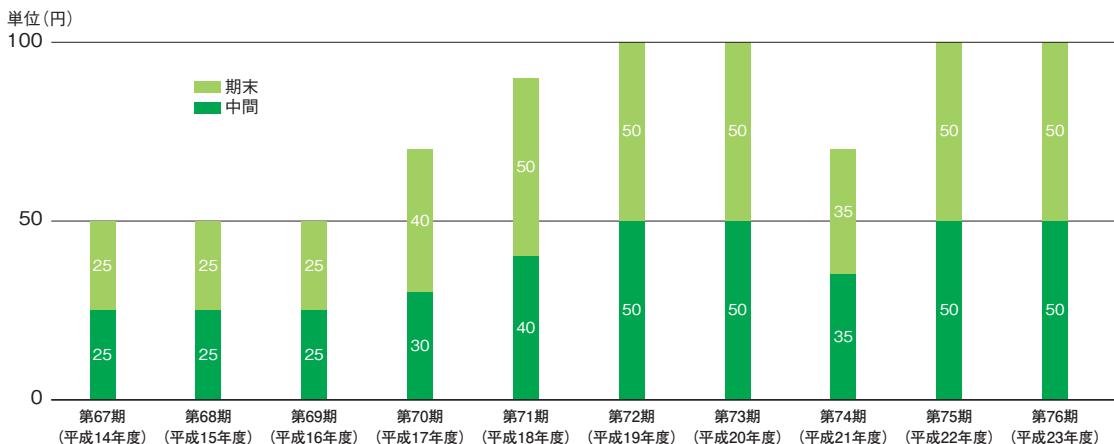
平成24年3月31日現在

順位	株主名	持株数(千株)	持株比率(%)
1	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	12,564	6.0
2	ジェーピー・モルガン・チェース・バンク 380055	9,905	4.7
3	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	9,348	4.4
4	日本生命保険相互会社	9,201	4.4
5	ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー	5,761	2.7
6	株式会社京都銀行	5,260	2.5
7	明治安田生命保険相互会社	5,240	2.5
8	SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT - TREATY CLIENTS	4,401	2.1
9	株式会社滋賀銀行	3,551	1.7
10	株式会社みずほコーポレート銀行	3,000	1.4

(注)持株比率は、発行済株式の総数から自己株式(14,186千株)を除いて計算しております。

株主還元

■ 1株当たり配当金の推移



■ 自己株式の取得

当社は資本効率の改善を目的に自己株式の取得を適宜実施しており、平成14年～平成20年の7年間で152,857百万円、29,716千株の自己株式を取得し、これまでに19,000千株を消却しました。

また、当期に15,000百万円、3,555千株の自己株式を取得しました。

会社概要

平成24年3月31日現在

■ 商号 株式会社 村田製作所

Murata Manufacturing Co., Ltd.

■ 設立 昭和25年12月23日（創業 昭和19年10月）

■ 資本金 69,377百万円

■ 従業員数 連結 36,967名 個別 7,075名

■ 所在地 本社 〒617-8555京都府長岡京市東神足1丁目10番1号 電話 075-951-9111

支社 東京支社・東京都渋谷区

事業所 長岡事業所・京都府長岡京市/八日市事業所・滋賀県東近江市/野洲事業所・滋賀県野洲市/横浜事業所・横浜市緑区

営業所 仙台/水戸/さいたま/東京/立川/浜松/名古屋/安曇野/京都/神戸/岡山/福岡

■ 国内関係会社 24社

■ 海外関係会社 50社

■ 代表取締役

取締役社長 村田 恒夫
 取締役副社長 藤田 能孝

■ 取締役

村田 恒夫
 藤田 能孝
 家木 英治
 牧野 孝次
 棚橋 康郎 (社外取締役)
 吉原 寛章 (社外取締役)

■ 監査役

常勤監査役 中山 素彦
 吉野 幸夫
 監査役 豊田 正和 (社外監査役)
 中西 倭夫 (社外監査役)
 西川 和人 (社外監査役)

■ 執行役員

常務執行役員 家木 英治
 牧野 孝次
 濱地 幸生
 執行役員 西村 昌雄
 小島 祐一
 井上 亨
 間所 新一
 岡田 剛和
 中島 規巨
 藺田 聡
 岩坪 浩
 前川 利弘
 竹村 善人
 鴻池 健弘
 丸山 英毅
 多田 裕
 石谷 昌弘
 水野 健一
 石野 聡
 フェロー 酒井 範夫

株主メモ

■ 事業年度

毎年4月1日から翌年3月31日まで

■ 剰余金の配当基準日

中間配当金 9月30日

期末配当金 3月31日

■ 単元株式数

100株

■ 株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関

東京都中央区八重洲一丁目2番1号

みずほ信託銀行株式会社

事務取扱場所

大阪市北区曾根崎二丁目11番16号

みずほ信託銀行株式会社 大阪支店証券代行部

郵便物送付／電話お問い合わせ先

〒168-8507

東京都杉並区和泉二丁目8番4号

みずほ信託銀行株式会社 証券代行部

0120-288-324 (通話料無料)

■ 公告の方法

当社ウェブサイトに掲載いたします。

(<http://www.murata.co.jp/>)

ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞に掲載いたします。

株式事務に関するご案内

■ お取扱窓口

証券会社に口座をお持ちの場合

お手続き
お問い合わせ先 お取引のある証券会社

お手続き内容 住所変更、名義変更、単元未満株式の買取請求、配当金受取り方法のご指定、相続に伴うお手続き等

証券会社等に口座をお持ちでない場合（特別口座の場合）

お手続き
お問い合わせ先 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
0120-288-324 (通話料無料)

<お取扱店>

みずほ信託銀行株式会社

本店および全国各支店

みずほインバスターズ証券株式会社

本店および全国各支店

お手続き内容 住所変更、名義変更、単元未満株式の買取請求、配当金受取り方法のご指定、相続に伴うお手続き等

特別口座での
留意事項 特別口座では、株式の売却はできません。売却するには、証券会社にお取引の口座を開設し株式の振替手続きが必要となります。

■ 未払い配当金のお支払い

上記のお取扱店に加え、株式会社みずほ銀行 本店および全国各支店で承ります。

※当社では単元未満株式の買取に関する手数料を無料としておりますので、ぜひご利用ください。(お取引証券会社等で株式を管理している場合は、お取引証券会社等で別途手数料のかかる場合がございます。)



Innovator in Electronics

muRata

株式会社 村田製作所